



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年10月30日

上場会社名 株式会社トーマンデバイス 上場取引所 東
 コード番号 2737 URL <http://www.tomendevices.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 妻木 一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 原 英記 TEL 03-3536-9150
 四半期報告書提出予定日 2019年11月13日 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	125,781	26.4	1,878	△14.1	1,867	13.4	1,376	21.4
2019年3月期第2四半期	99,493	△5.1	2,186	45.5	1,647	25.9	1,133	21.5

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 1,202百万円 (△7.6%) 2019年3月期第2四半期 1,301百万円 (21.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第2四半期	202.46	175.04
2019年3月期第2四半期	166.72	149.69

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2020年3月期第2四半期	103,252	29,869	28.7	4,364.14
2019年3月期	79,694	29,278	36.5	4,280.46

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 29,682百万円 2019年3月期 29,113百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	-	0.00	-	90.00	90.00
2020年3月期	-	0.00	-	-	-
2020年3月期（予想）	-	-	-	100.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

配当予想の修正については、本日（2019年10月30日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	240,000	10.3	3,370	△4.5	3,350	26.9	2,400	26.2	352.89

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2019年10月30日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2020年3月期2Q	6,802,000株	2019年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	2020年3月期2Q	611株	2019年3月期	611株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期2Q	6,801,389株	2019年3月期2Q	6,801,389株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
3. 補足情報	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の堅調な推移を背景に緩やかな回復を続けております。しかしながら、米中貿易摩擦の激化や英国のEU離脱問題等に見られる海外経済への影響など先行き不透明な状況が継続しております。

エレクトロニクス業界におきましては、市場を牽引しておりましたスマートフォン市場の普及一巡や、データセンター需要の停滞により、当社の主要取扱製品であるメモリー等の在庫調整に遅れが生じる等、市場全体の縮小トレンドが継続しております。

このような状況下、当社グループは、新規顧客開拓や既存ビジネスのシェア拡大により、国内市場においてデータセンターストレージ向けにNAND FLASH製品の販売が好調であったこと、ファウンドリービジネス等の新規商材の売上が伸びたこと、海外市場においては引き続き高精細カメラCIS (CMOSイメージセンサー) を拡販したこと、またメモリーのシェアを確保出来たことから売上高は1,257億81百万円 (前年同期比26.4%増) と第2四半期連結累計期間では過去最高を更新いたしました。しかし、メモリー価格の下落等、当社グループを取り巻く市場環境は依然厳しく、営業利益は18億78百万円 (同14.1%減) となりましたが、前受金の増加に伴い現金及び預金が増加したことにより金融収支が改善したため、経常利益は18億67百万円 (同13.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億76百万円 (同21.4%増) となりました。

なお、品目別の実績については、6ページの「3. 補足情報 (品目別販売実績)」をご参照ください。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、特に現金及び預金、商品および前受金が増加しました。

中国においてNAND FLASHやDRAMモジュールのビジネスの拡大に伴い商品が増加 (118億9百万円) したことにより資金が減少しましたが、前受金が増加 (258億17百万円) したことにより資金が増加し、その結果、現金及び預金が増加しました。

総資産の残高は1,032億52百万円 (前連結会計年度末比29.6%増) となりました。これは主に現金及び預金および商品が増加したことによるものです。

負債は733億82百万円 (同45.6%増) となりました。これは主に前受金が増加したことおよび短期借入金が増加したことによるものです。

純資産は298億69百万円 (同2.0%増) となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間において新規ビジネスの貢献等もあり業績が好調に推移したことから、2019年4月26日に公表いたしました2020年3月期 (2019年4月1日～2020年3月31日) の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日 (2019年10月30日) 公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,161	18,249
受取手形及び売掛金	47,632	45,364
商品	11,868	23,678
前渡金	11,603	12,830
預け金	2,581	1,106
その他	336	567
流動資産合計	78,184	101,798
固定資産		
有形固定資産	46	89
無形固定資産	253	222
投資その他の資産	1,209	1,141
固定資産合計	1,509	1,453
資産合計	79,694	103,252
負債の部		
流動負債		
買掛金	29,278	32,176
短期借入金	5,882	—
未払法人税等	354	526
前受金	3,119	28,937
賞与引当金	128	131
未払金	10,419	11,050
その他	805	118
流動負債合計	49,987	72,941
固定負債		
退職給付に係る負債	389	402
その他	38	39
固定負債合計	428	441
負債合計	50,416	73,382
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	1,984	1,984
利益剰余金	24,398	25,163
自己株式	△1	△1
株主資本合計	28,435	29,200
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	273	203
繰延ヘッジ損益	△20	△8
為替換算調整勘定	424	286
その他の包括利益累計額合計	677	481
非支配株主持分	165	187
純資産合計	29,278	29,869
負債純資産合計	79,694	103,252

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	99,493	125,781
売上原価	96,079	122,564
売上総利益	3,414	3,216
販売費及び一般管理費	1,228	1,337
営業利益	2,186	1,878
営業外収益		
受取利息	1	143
受取配当金	7	8
持分法による投資利益	—	23
その他	13	4
営業外収益合計	22	179
営業外費用		
支払利息	185	47
債権売却損	25	10
為替差損	310	119
持分法による投資損失	28	—
その他	11	11
営業外費用合計	561	189
経常利益	1,647	1,867
税金等調整前四半期純利益	1,647	1,867
法人税等	496	463
四半期純利益	1,150	1,404
非支配株主に帰属する四半期純利益	16	27
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,133	1,376

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	1,150	1,404
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	16	△70
繰延ヘッジ損益	△78	12
為替換算調整勘定	212	△143
その他の包括利益合計	150	△201
四半期包括利益	1,301	1,202
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,276	1,181
非支配株主に係る四半期包括利益	25	21

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 補足情報

(品目別販売実績)

品目別	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
メモリー	59,736	60.0	71,038	56.5	18.9	134,496	61.8
システムLSI	24,248	24.4	36,466	29.0	50.4	49,163	22.6
半導体小計	83,984	84.4	107,504	85.5	28.0	183,659	84.4
液晶デバイス	8,978	9.0	11,433	9.1	27.3	20,413	9.4
その他	6,531	6.6	6,844	5.4	4.8	13,560	6.2
合計	99,493	100.0	125,781	100.0	26.4	217,632	100.0

(メモリー半導体)

DRAM、NAND FLASH等の価格は依然、緩やかな下落が継続しているものの、新規顧客の獲得が順調に進んでおり、主に国内市場でデータセンターストレージ向けにNAND FLASH製品の売上が堅調であったこと、また、中国市場においてもNAND FLASH製品の売上が増加したこと、国内外において既存ビジネスのシェア拡大したこと、この分野の売上高は710億38百万円(前年同期比18.9%増)となりました。

(システムLSI)

中国市場においてスマートフォンの複眼化および高精細化によりCISの売上が大きく伸びていること、国内市場では丸文セミコン株式会社(株)の事業を譲受けたことにより、新たにファウンドリービジネスが売上に貢献したこと、この分野の売上高は364億66百万円(同50.4%増)となりました。

(液晶デバイス)

液晶パネルの価格の下落は継続しているものの、主に海外市場でテレビ向け液晶パネルの売上堅調であったこと、国内市場では大型テレビ向けの液晶パネルの売上が伸びたことから、この分野の売上高は114億33百万円(同27.3%増)となりました。

(その他)

国内市場では有機ELパネルがスマートフォンの新モデルに採用され販売を伸ばしましたが、工作機等向けのバッテリー等の売上が減少したことから、この分野の売上高は68億44百万円(同4.8%増)となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP(マルチチップ・パッケージ)、SSD(ソリッドステートドライブ)等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC(システム・オン・チップ)、DDI(ディスプレイドライバーIC)、CIS(CMOSイメージセンサー)等

「液晶デバイス」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD(液晶パネル)等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、有機EL、MLCC(積層セラミックコンデンサ)、バッテリー等